

证券代码：002185

证券简称：华天科技

天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

| | |
|--------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 海通证券股份有限公司 肖隽翀、张幸 华泰柏瑞基金管理有限公司 陈乐 公司接待人员：副总经理及董事会秘书常文瑛、证券部部长许腾旭、证券事务代表杨彩萍 |
| 时间 | 2024年5月8日下午 |
| 地点 | 公司子公司华天科技（西安）有限公司 |
| 形式 | 现场交流 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>交流内容主要如下：</p> <p>1、公司目前主要生产基地及经营情况</p> <p>公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。天水基地以引线框架类产品为主，产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NOR Flash 等。西安基地以基板类和 QFN、DFN 产品为主，产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。南京基地以存储器、射频、MEMS 等集成电路产品的封装测试为主，涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。昆山基地为封装晶圆级产品，主要产品包括 TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out 等。韶关基地以引线框架类封装产品、显示器件和显示模组产品为主。Unisem 封装产品包括引线框架类、基板类以及晶圆级产品，主要以射频类产品为主。公司新建的基地华天科技（江苏）有限公司、上海华天集成电路有限公司已进入试生产阶段。</p> <p>集成电路行业从 2022 年开始进入下行调整周期，并在 2023 年一季度形成低谷，2023 年二季度以来，市场逐步缓慢恢复，从公司经营来看，2023 年各季度收入规模逐季向好。2024 年一</p> |

季度收入 31.06 亿元，同比增长 38.72%。

2、未来行业发展趋势

全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济和下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。近年来，在政策支持、市场需求及资本推动等因素合力下，我国半导体产业规模快速增长，占全球市场的比重持续提高。消费电子、高速发展的计算机和网络通信等市场应用已成为我国集成电路的主要应用领域，随着智能手机、平板电脑等消费电子的升级换代，以及传统产业的转型升级，汽车电子、安防、人工智能等应用场景的持续拓展，将持续拉动对集成电路的旺盛需求。

在我国集成电路产业链中，封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。

随着国内封装测试企业在 BGA、FC、WLCSP、Bumping、TSV、SiP、FO 等先进封装领域布局完善和先进封装产能持续释放，以及并购整合的持续进行，国内企业有能力承接全球集成电路封装业务转移，市场规模和市场集中度有望进一步提升。

3、公司股权激励实施情况

公司此次股权激励计划是公司上市以来，第一次推出股权激励。封装测试企业是人员密集型企业，经过 20 年发展，公司员工总数已超过 2 万人，单靠工资薪金已经不能满足公司发展需要，通过股权激励的实施可以有效补充薪酬模式，可以吸引和留住优秀人才。公司希望通过股权激励计划的实施，调动激励对象的积极性，提升激励对象的工作热情，稳定员工队伍。

公司本次股权激励计划首次授予的股票期权已于 2024 年 1 月 30 日完成登记，首次授予的股权期权 23,138 万份，首次授予的激励对象人数为 2,728 人，激励对象范围为公司及全资子公司

| | |
|---|--|
| | <p>司、控股子公司的核心技术人员、核心业务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包含公司董事、高级管理人员以及不得作为激励对象的公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。</p> <p>4、近几年包括公司在内的封测企业都进行了并购，公司还会进行并购吗</p> <p>公司于 2019 年 1 月完成以要约方式收购 Unisem 股份事项，并将 Unisem 纳入合并范围。目前公司持有 Unisem 42.73%股份。后续，公司仍将积极寻找符合公司发展战略的并购项目，通过资源整合，不断提升公司封装技术水平，优化客户结构，提高市场份额，促进公司稳健发展。</p> <p>5、大股东增持股份情况</p> <p>公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司计划自 2023 年 10 月 24 日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于 1.2 亿元，截至 2024 年 4 月 23 日，华天电子集团增持金额合计 1.62 亿元，华天电子集团本次增持计划已实施完成。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及应披露的重大信息</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |